
7. Level 2 Repair

7-1. 부품배치도

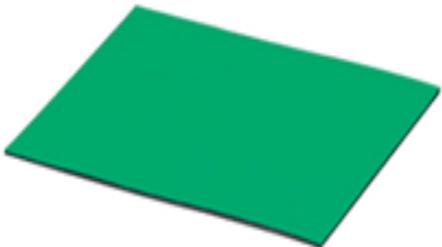
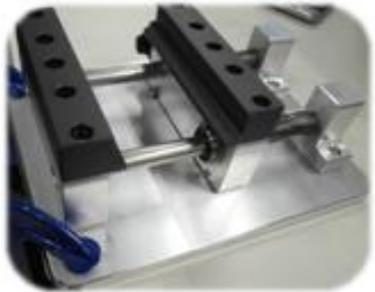


삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

7-2. 준비물

	
Tweezers / Disass'y Stick / Screw Driver	Anti-static Gloves
	
Anti-static Mat	Hot Plate
	
A OCTA Disassembly Holder	OCTA Disassembly Upper
	
Ethyl Alcohol	Cotton Swab

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

7-3. 분해 시 필수 교체 자재 리스트

BOM description & part code	Image	Remarks
Backglass Rework Tape [GH81-16727A]	 A rectangular, green-tinted adhesive tape with a black border, used for backglass repair.	백글라스 수리시, 새로운 테잎으로 교체 사용
Fingerprint Tape [GH81-16716A]	 A circular, black adhesive tape with a blue tab, used for fingerprint sensor repair.	지문센서 재조립시, 기존 테잎 제거 후 새 테잎 사용

7. Level 2 Repair

7-4. 분해도

1

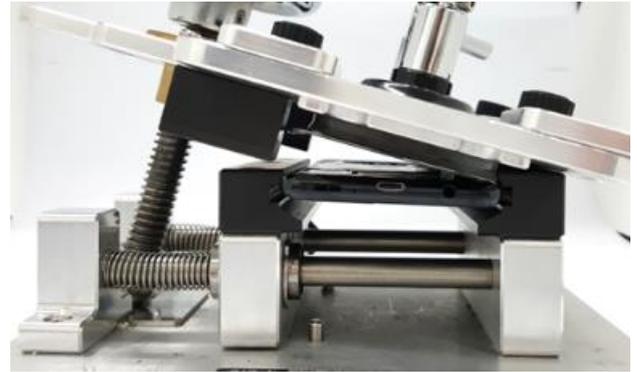
세트를 65~75°C 챔버에 넣어 10~20
동안 가열한다.



※ Caution
스크래치 조심한다.

2

백글라스를 해체한다.



※ Caution
리어 데미지에 주의한다.

3

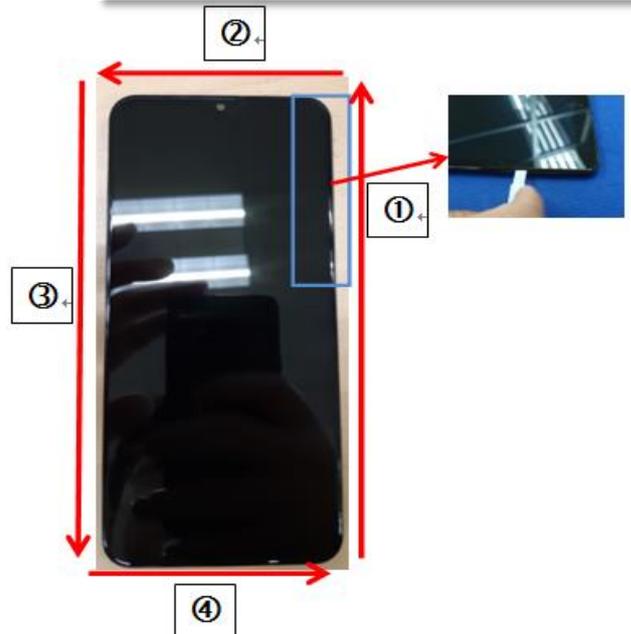
SIM / SD 트레이를 제거한다.



※ Caution
스크래치 조심한다.

4

리어 커버를 제거한다
SIM/SD → 상단 → 우측 → 하단



※ Caution
스크래치 조심한다.

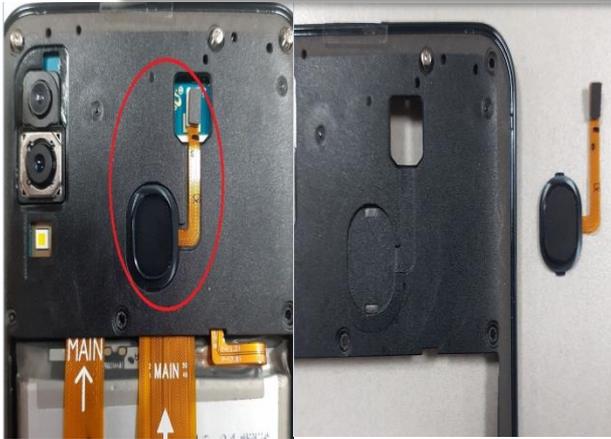
삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

5

해체 툴을 사용하여 지문센서 FPCB 를 제거하고 지문센서를 분리한다



※ Caution

- 1) 스크래치 조심한다
- 2) 리어 및 지문센서 데미지에 주의한다.

6

리어 스크류 13 포인트를 제거한다

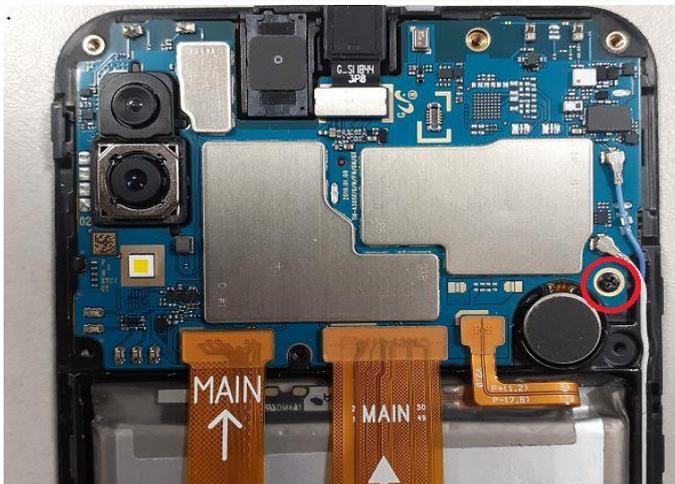


※ Caution

리어 데미지에 주의한다.

7

PBA SCREW 1 포인트 해체한다.

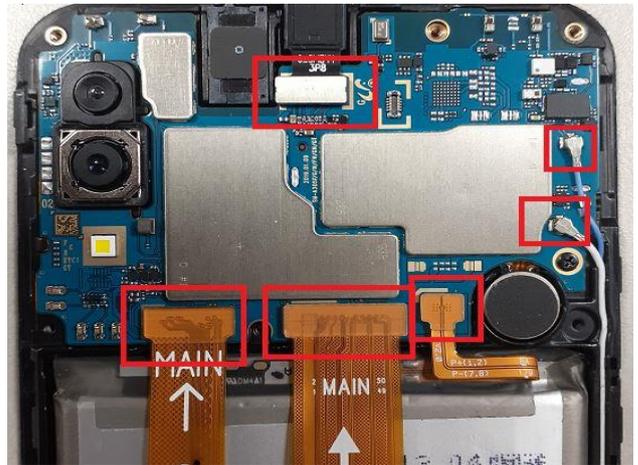


※ Caution

PBA 파손/충격에 주의한다.

8

PBA, C to C FPCB, 배터리 커넥터, 동축케이블 2종, VT 카메라를 제거한다.



※ Caution

커넥터 및 Cable 파손/충격에 주의한다.

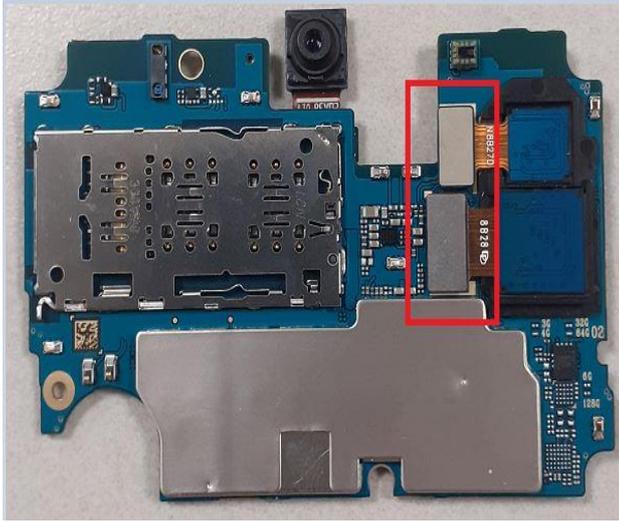
삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

9

카메라 커넥터들을 분해한다.

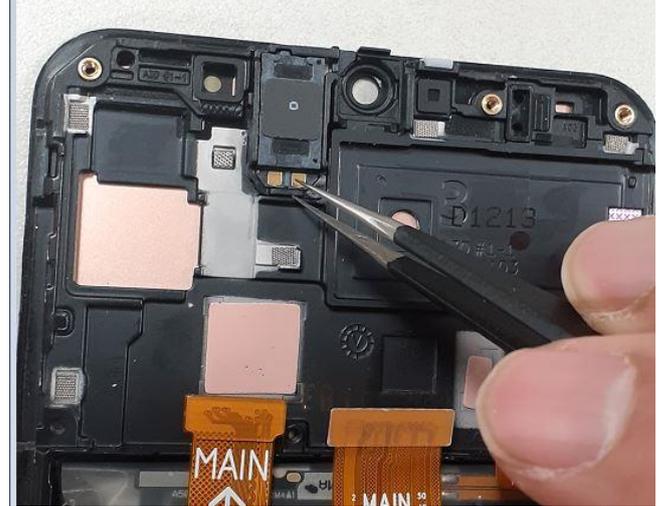


※ Caution

카메라 모듈 데미지에 유의한다.

10

Front Ass'y 에서 RCV 를 제거한다



※ Caution

분해시 스크래치/파손/충격에 주의한다.

11

Front Assy 에서 모터를 제거한다.

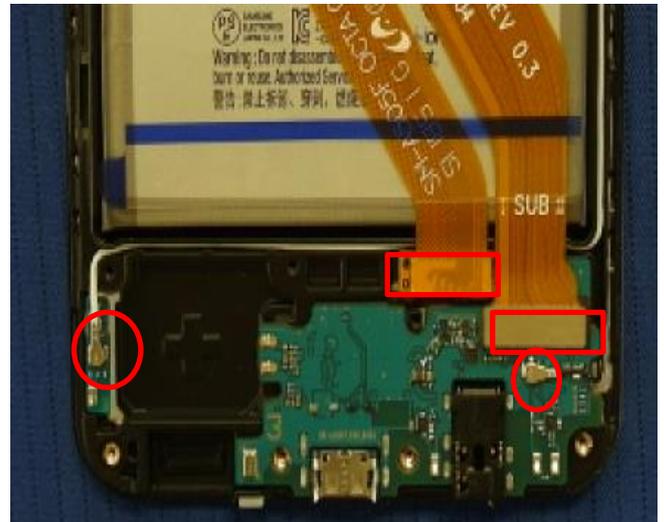


※ Caution

모터 데미지에 유의한다.

12

C to C FPCB 와 동축케이블 2 종을 제거한다



※ Caution

C to C FPCB 와 동축케이블 2 종 데미지에 유의한다.

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

13

HB PBA 와 SUB PBA 를 분해한다.



※ Caution

HB PBA 와 Sub PBA 파손에 유의한다..

14

Rear Ass'y 에서 SPK 를 제거한다.



※ Caution

SPK 데미지에 유의한다.

7. Level 2 Repair

7-5. 조립도

1

Rear Ass'y.에 SPK 를 조립한다



※ Caution

SPK 데미지에 유의한다.

2

Front Ass'y.에 HB PBA 와 SUB PBA 를 조립한다

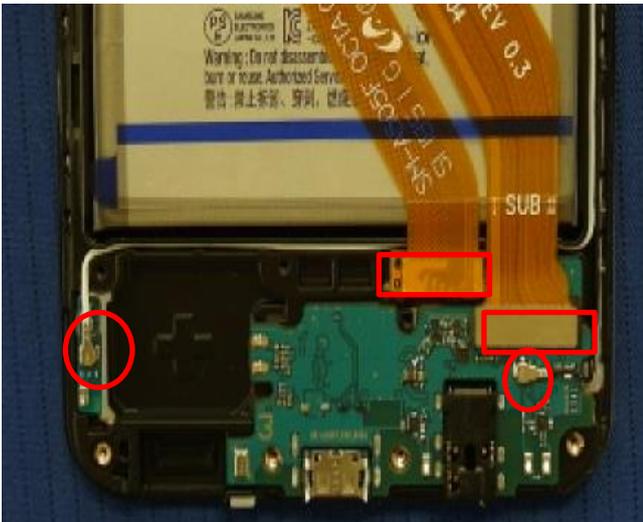


※ Caution

Sub PBA 데미지에 유의한다

3

C to C FPCB 와 동축케이블 2 종을 조립한다.

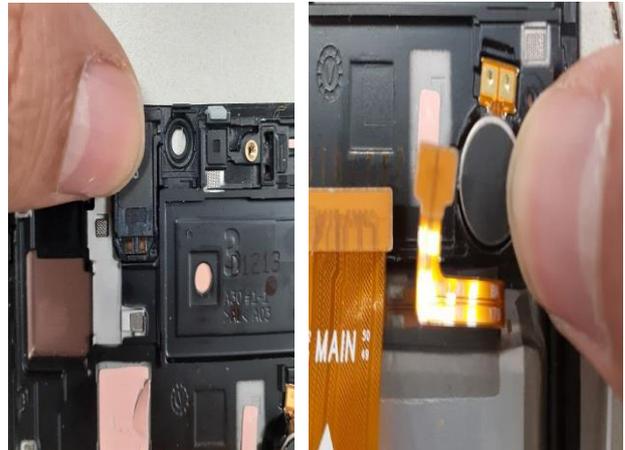


※ Caution

C to C FPCB 와 동축케이블 조립 가이드라인을 지킨다.

4

모터와 리시버를 조립한다.



※ Caution

- 1) 카메라 렌즈 스크래치에 유의한다.
- 2) 각 자재 데미지에 유의한다.

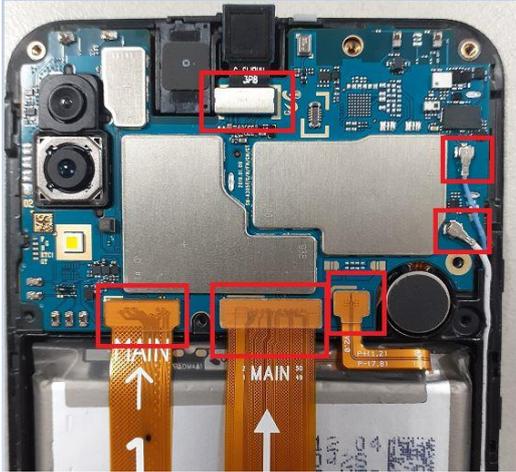
삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

5

PBA , C to C FPCB , 배터리커넥터, 2 종 동축 케이블, VT Camera 를 조립한다



※ Caution

각 커넥터의 연결여부를 확인한다

6

PBA 스크류 1 포인트를 조인다

* 토크값 : $1.2 \pm 7\%$



※ Caution

PBA 데미지에 유의한다.

7

리어를 조립하고 13 포인트 스크류를 조인다* *
토크값 : $1.2 \pm 7\%$

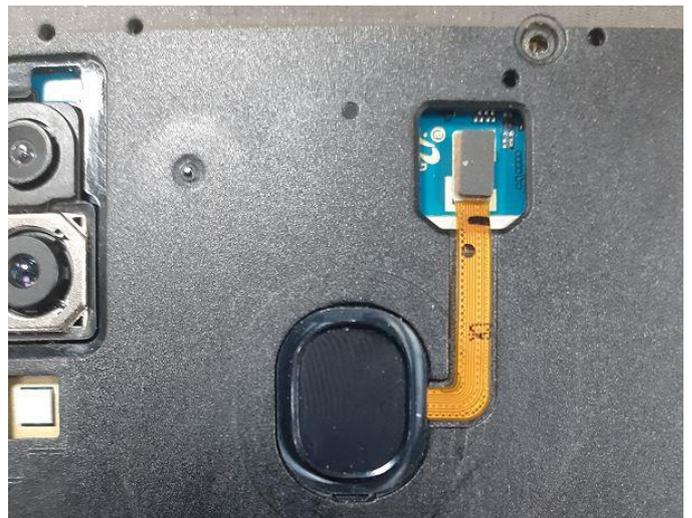


※ Caution

PBA 데미지에 유의한다.

8

지문모듈을 조립하고 FPCB 를 연결한다



※ Caution

지문 FPCB 의 데미지에 유의한다

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

9

리어 커버를 조립하고 SIM/SD Tray 를 체결한다.



※ Caution

리어 커버의 스크래치에 유의한다

10

Backglass 조립 후 압착한다.



※ Caution

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.